

2022年2月17日

株式会社ADEKA

台湾に先端ロジック半導体向け材料の新プラントを建設

株式会社ADEKA（代表取締役社長：城詰 秀尊）は、連結子会社である台湾艾迪科精密化学股份有限公司にて先端ロジック半導体向け材料の新プラント建設を決定しましたのでお知らせいたします。本プラントは、韓国・ADEKA KOREA CORP. に次ぐ半導体材料の海外生産拠点です。

半導体市場は5G通信の拡大やAI、メタバースをはじめとした高度ICT社会の実現に向けて、2030年には市場規模1兆ドルに成長する見込みであり、半導体のさらなる技術革新が求められています。なかでも、制御や演算処理を行うロジック半導体は微細化のスピードが速く、半導体フォトリソグラフィ工程でEUVプロセスが本格導入される2023年前後には製造プロセスや材料の技術が革新される見通しです。使用される材料も高純度化し、品質管理基準が強化された新素材に置き換わることが予想されます。

ADEKAはロジック半導体の技術革新をビジネスチャンスと捉え、研究開発および生産が活発な台湾で新プラントを建設することとしました。本プラント建設により、台湾におけるロジック半導体ビジネスへ本格参入し、当社半導体分野の事業拡大を図ります。今後、半導体の集積密度を高める3次元実装技術向け材料への進出等により、先端半導体向け材料のラインナップ拡大を目指します。

ADEKAは先端半導体材料の提供を通じて、高度ICT社会の実現に貢献してまいります。

◆ 新プラント概要

所在地	台湾艾迪科精密化学股份有限公司（台南市安南区工業六路32号）
投資金額	25億円
延床面積	3,068平方メートル
スケジュール（予定）	着工：2023年8月、営業運転開始：2024年4月



▲ 台湾艾迪科精密化学股份有限公司

補足1：ロジック半導体の微細化とADEKAの先端材料について

ロジック半導体は、半導体チップの小型化と演算処理能力向上を目的に微細化が進行しています。さらなる微細化には、1枚のシリコンウエハにできるだけ多くのチップを搭載させる「トランジスタの集積数増加」が求められ、配線の微細加工がカギを握っています。当社の材料は、EUV露光プロセスが適用される最先端ロジック半導体の配線工程（ALD成膜）において使用されます。当社ALD材料は、微細化になくてはならない材料として評価を得ています。

補足2：ADEKA 情報・電子化学品事業について

情報・電子化学品事業は、半導体分野やディスプレイ分野で高度ICT社会の発展に欠かせない先端“素材”を提供しています。付加価値の高い世界トップシェア製品を多数有しており、高誘電材料「アデカオルセラ」シリーズは先端半導体DRAM用途で世界シェア50%以上を占めています。ADEKAグループ中期経営計画『ADX 2023』（2021-2023年度）では、「次世代ICT分野」を重要分野の一つと位置付け、飛躍的な規模拡大を目指してまいります。

以 上

■本リリースについてのお問い合わせ先

株式会社ADEKA 法務・広報部 総務・広報グループ Tel:03-4455-2803

